

# 株式会社東京精密 平成31年(2019年)3月期 第3四半期決算概要

2019年2月13日  
株式会社東京精密  
証券コード 7729

## ◆ 将来の事象に係わる記述に関する注意

- 本資料に記載されている情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- 従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

## ◆ 表記データ・用語について

- 注記がある場合を除き、半導体製造装置セグメントを「半導体」、精密計測機器セグメントを「計測」、また親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」と記載します。
- 記載されている金額や比率の情報は、注記がある場合を除き、億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為、内訳の計が、合計と一致しない場合があります。

## ◆ 監査について

- 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

単位: 億円	2017年度	2018年度	
	第3四半期(累計)	第3四半期(累計)	前年同期比 Y/Y
<b>売上高</b>	<b>629</b>	<b>749</b>	+ 19%
半導体製造装置	429	511	+ 19%
計測機器	200	238	+ 19%
<b>営業利益</b>	<b>125</b>	<b>150</b>	+ 20%
半導体	85	99	+ 16%
同率	20%	19%	-
計測	40	51	+ 28%
同率	20%	22%	-
<b>経常利益</b>	<b>127</b>	<b>156</b>	+ 23%
<b>当期純利益</b>	<b>90</b>	<b>114</b>	+ 27%

➤ 両事業とも前年同期比 増収増益の着地

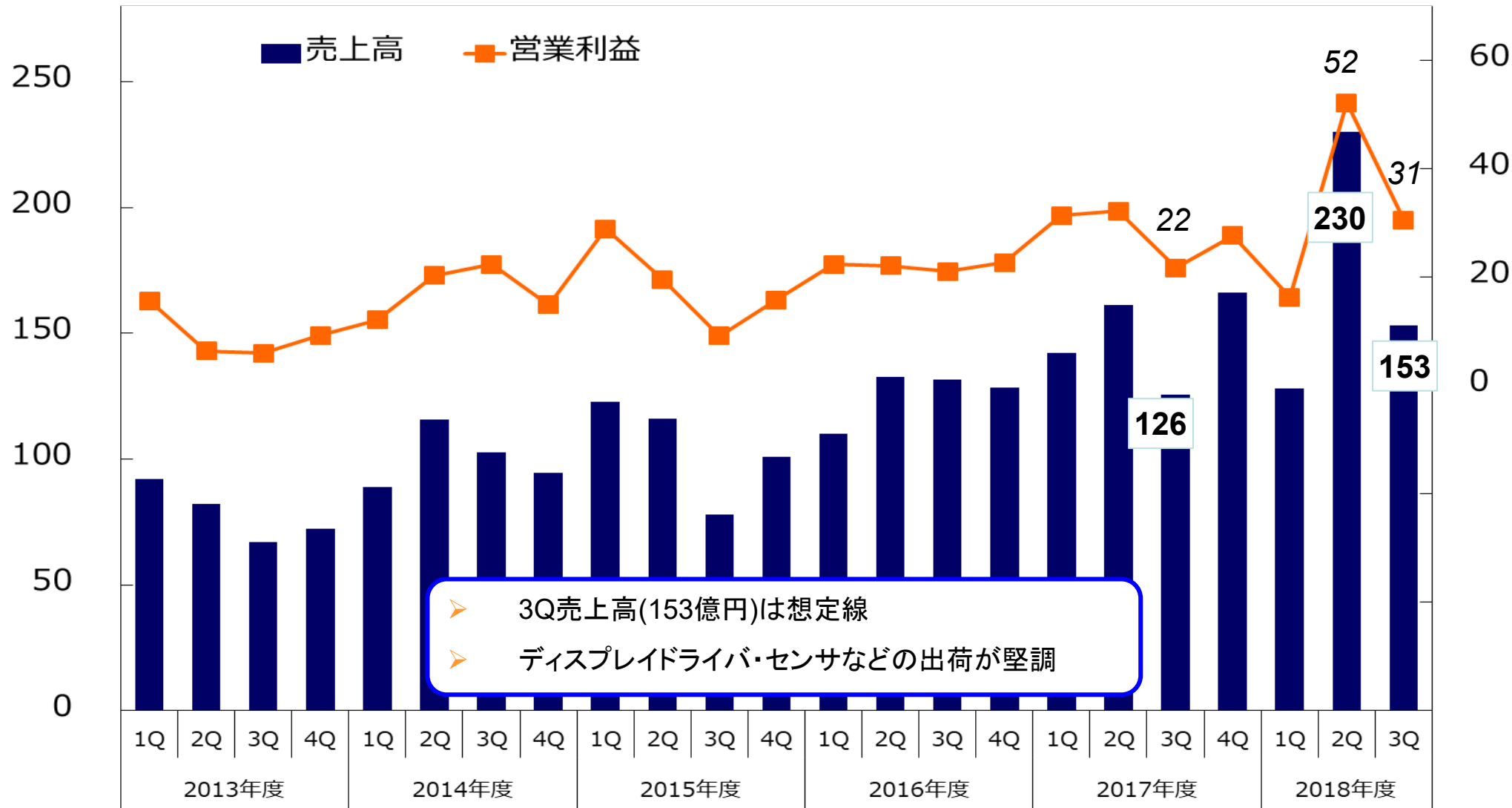
単位: 億円

	2017年度				2018年度				
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	前 四半期比 Q/Q	前年 同期比 Y/Y
売上高	199	238	192	253	198	314	237	- 24%	+23%
半導体製造装置	142	161	126	166	128	230	153	- 33%	+22%
計測機器	57	76	67	87	70	84	84	+1%	+26%
営業利益	40	49	36	48	31	71	48	- 33%	+32%
半導体	31	32	22	28	16	52	31	- 41%	+41%
同率	22%	20%	17%	17%	13%	23%	20%		
計測	9	17	14	20	15	19	17	- 9%	+ 20%
同率	16%	22%	22%	23%	21%	23%	21%		
経常利益	41	49	36	46	34	74	48	- 35%	+32%
当期純利益	29	35	26	38	26	53	35	- 35%	+34%

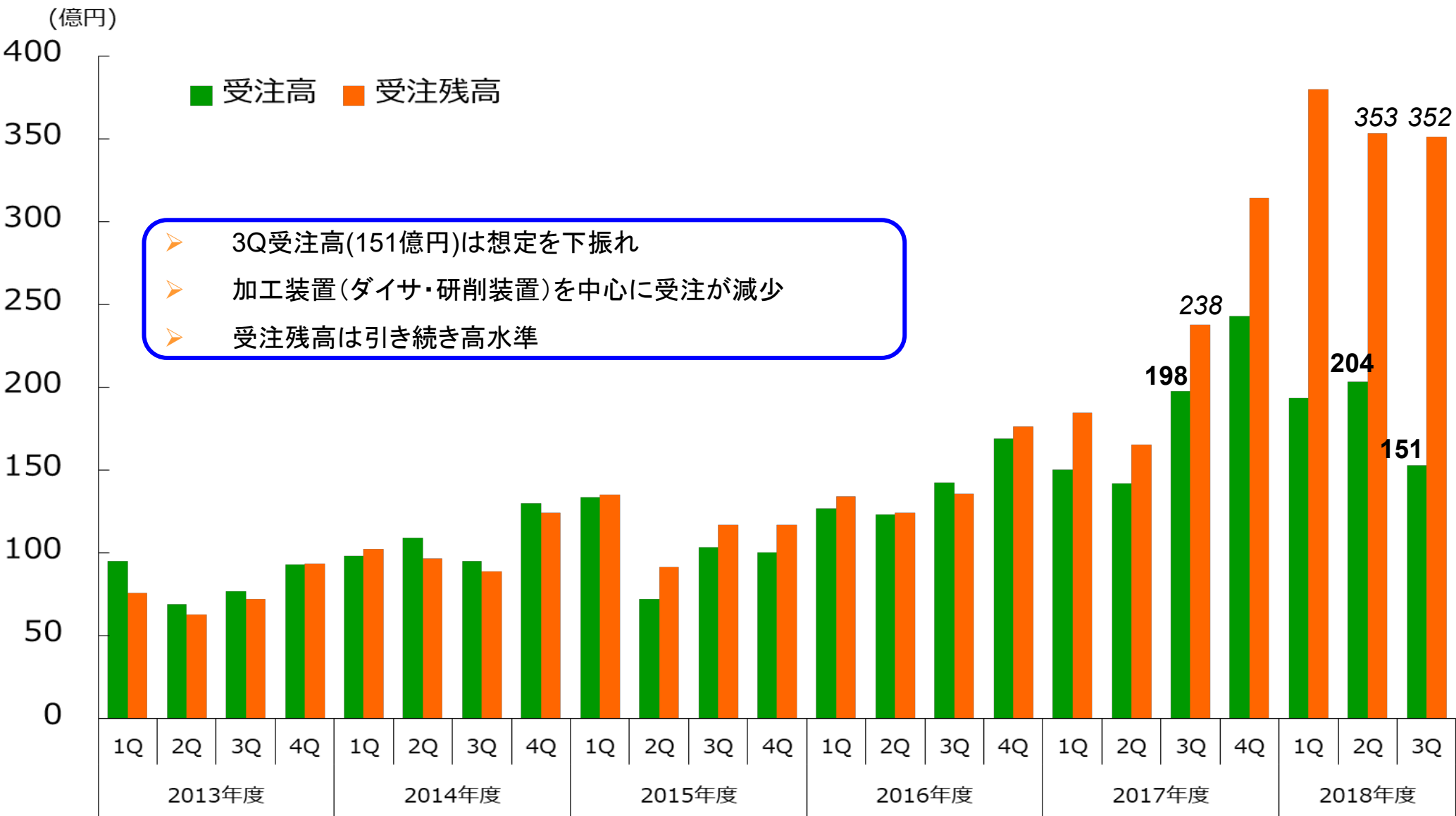
➤ 両事業とも前年同期比 増収増益の着地

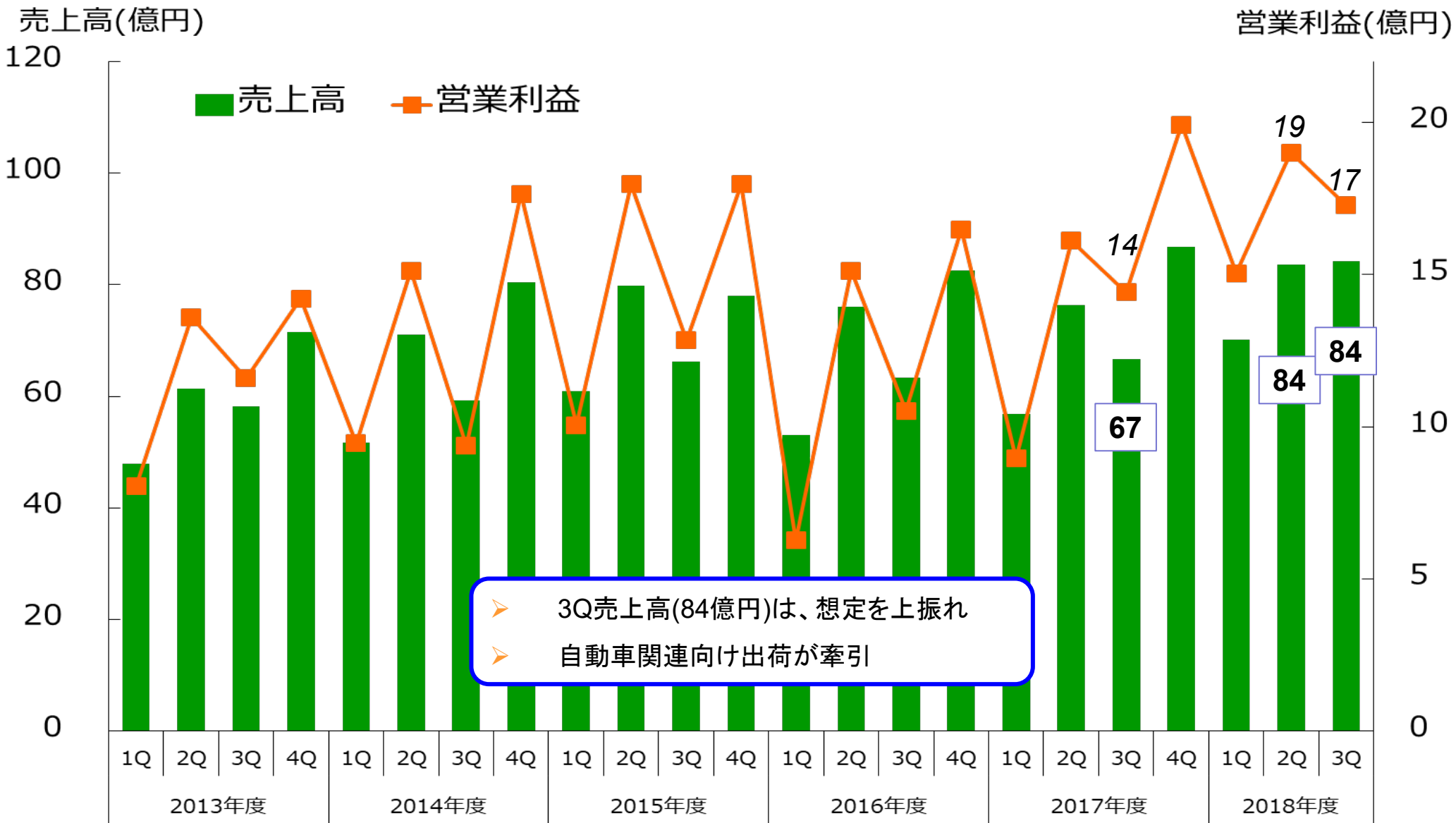
売上高(億円)

営業利益(億円)

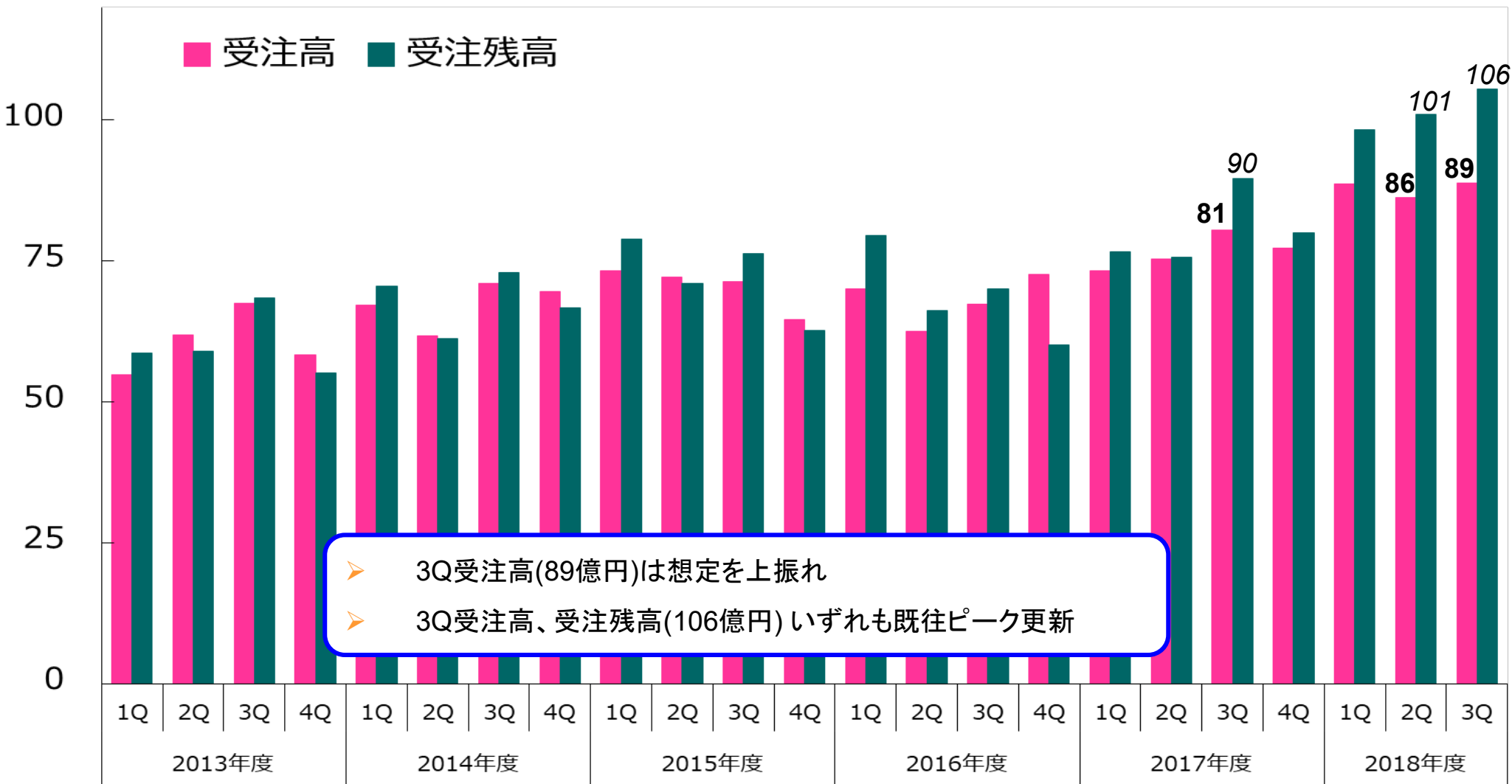


➤ 3Q売上高(153億円)は想定線  
 ➤ ディ스플레이ドライバ・センサなどの出荷が堅調





(億円)

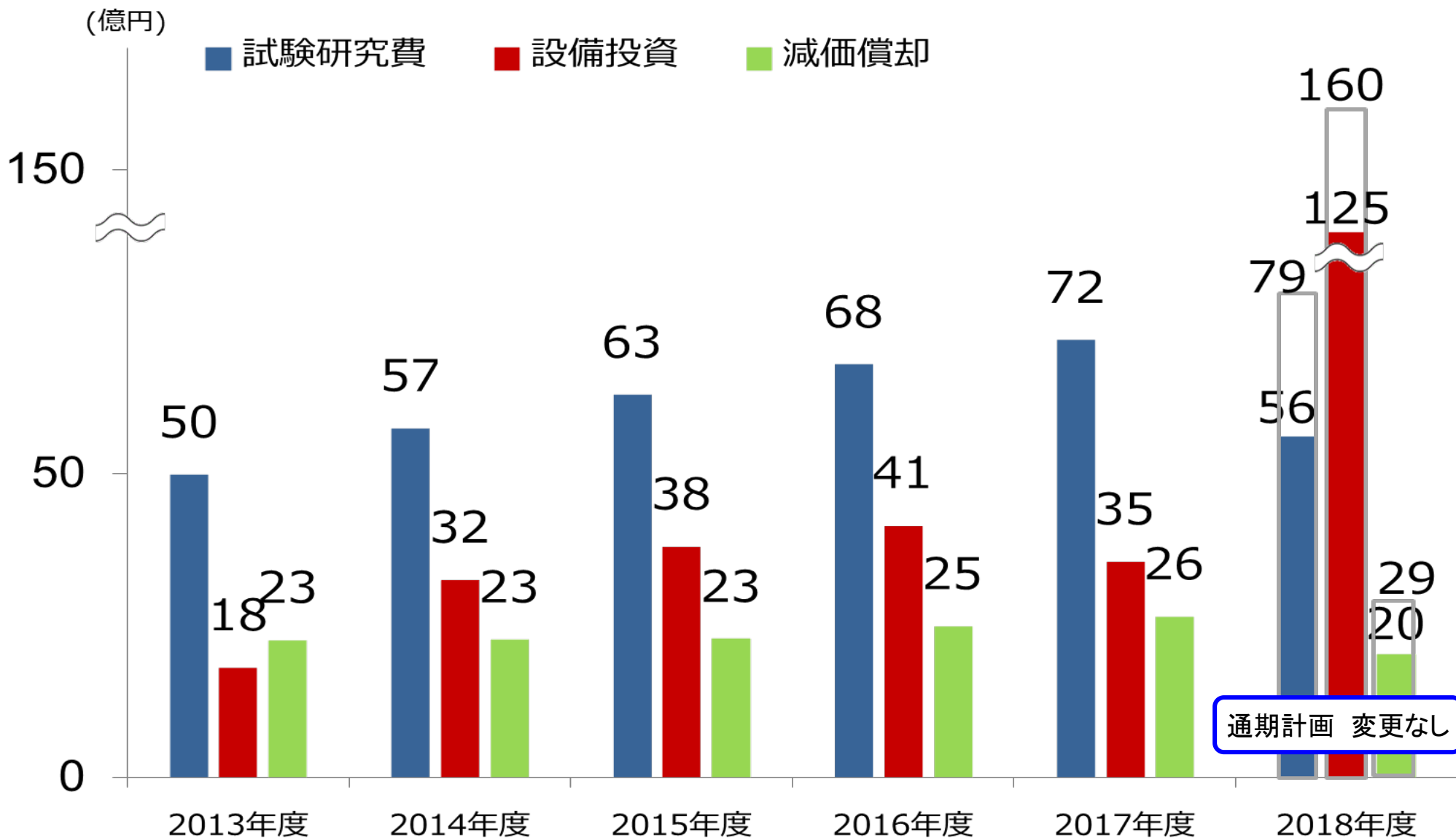


➤ 3Q受注高(89億円)は想定を上振れ  
 ➤ 3Q受注高、受注残高(106億円) いずれも既往ピーク更新



資産 (億円)	18/3末	18/12 末	増減	負債/純資産 (億円)	18/3末	18/12 末	増減
現預金	372	<b>398</b>	<b>+26</b>	支手・買掛金, 電子記録債務	219	<b>270</b>	<b>+51</b>
受取手形・ 売掛金・ 電子記録債権	334	<b>342</b>	<b>+7</b>	短期借入金	13	<b>13</b>	<b>±0</b>
在庫	223	<b>291</b>	<b>+68</b>	その他	96	<b>105</b>	<b>+9</b>
その他	20	<b>19</b>	<b>-1</b>	<b>流動負債計</b>	<b>328</b>	<b>388</b>	<b>+60</b>
<b>流動資産計</b>	<b>950</b>	<b>1,050</b>	<b>+100</b>	<b>固定負債計</b>	<b>7</b>	<b>89</b>	<b>+82</b>
<b>固定資産計</b>	<b>379</b>	<b>474</b>	<b>+95</b>	<b>負債計</b>	<b>335</b>	<b>477</b>	<b>+142</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,329</b>	<b>1,524</b>	<b>+195</b>	<b>純資産</b>	<b>994</b>	<b>1,047</b>	<b>+53</b>
				<b>負債・純資産合計</b> (内有利子負債)	<b>1,329</b> <b>(13)</b>	<b>1,524</b> <b>(114)</b>	<b>+195</b> <b>(+101)</b>

➤ 日野工場棟・用地取得(半導体)



## 半導体

- 受注はメモリ投資減速などにより減少局面
- 需要の短期的な回復は見込めない状況
- 一方、生産は逼迫状態が続く

## 計測

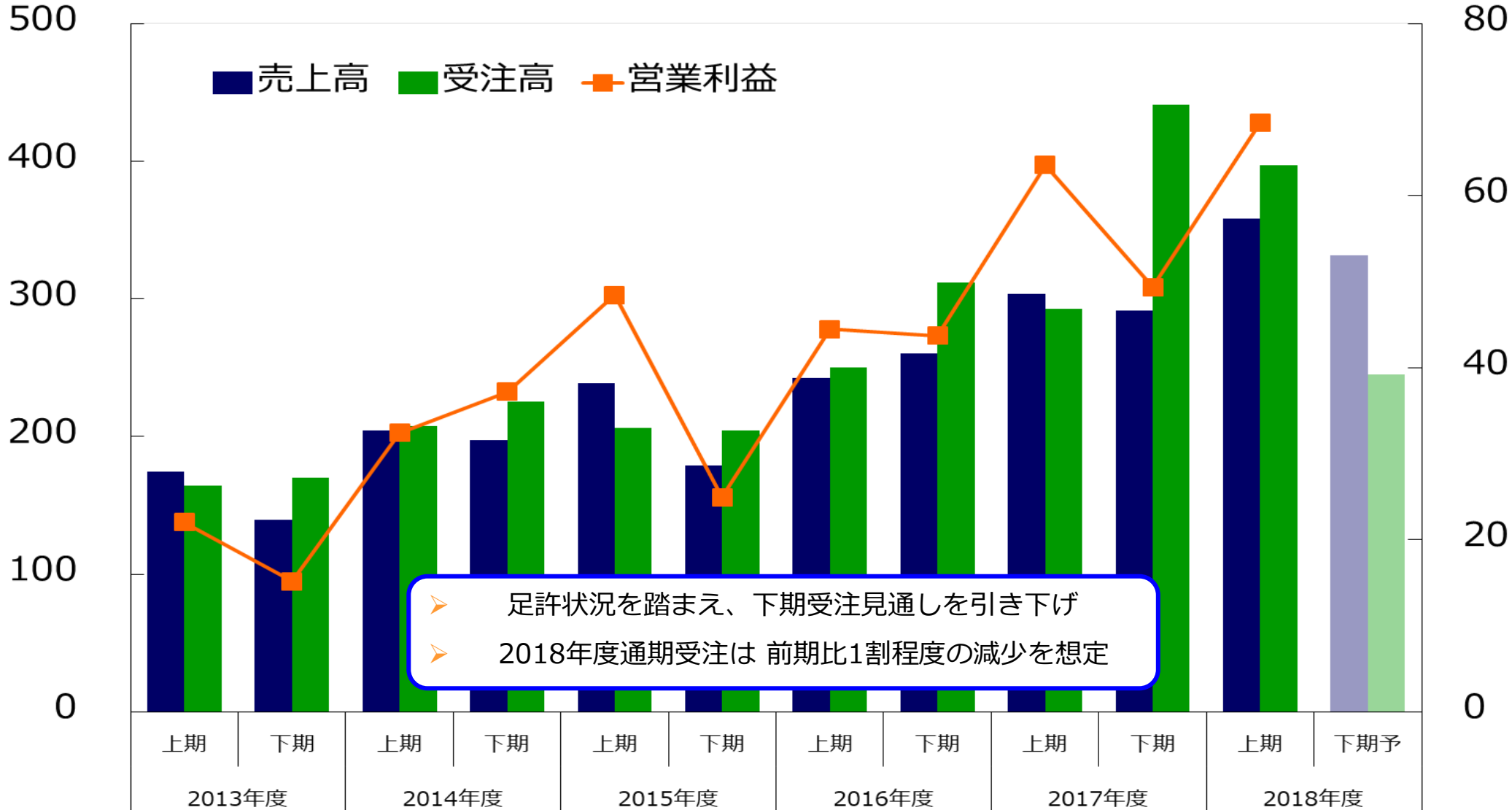
- 自動車関連を中心に、国内モノづくり需要は堅調さを維持
- 米中貿易摩擦、各種通商協議の影響を引き続き注視

単位：億円	2018年度予想	前回予想対比(増減)
	通期予想	通期予想
売上高	<b>1,000</b>	<b>±0</b>
半導体製造装置	690	±0
計測機器	310	±0
営業利益	<b>187</b>	<b>±0</b>
同率	19%	-
経常利益	<b>189</b>	<b>±0</b>
当期純利益	<b>136</b>	<b>±0</b>
1株配当	98 円(普通配当) 20 円(記念配当)	<b>±0円</b>

前回予想公表：2018年11月13日

売上高・受注高(億円)

営業利益(億円)

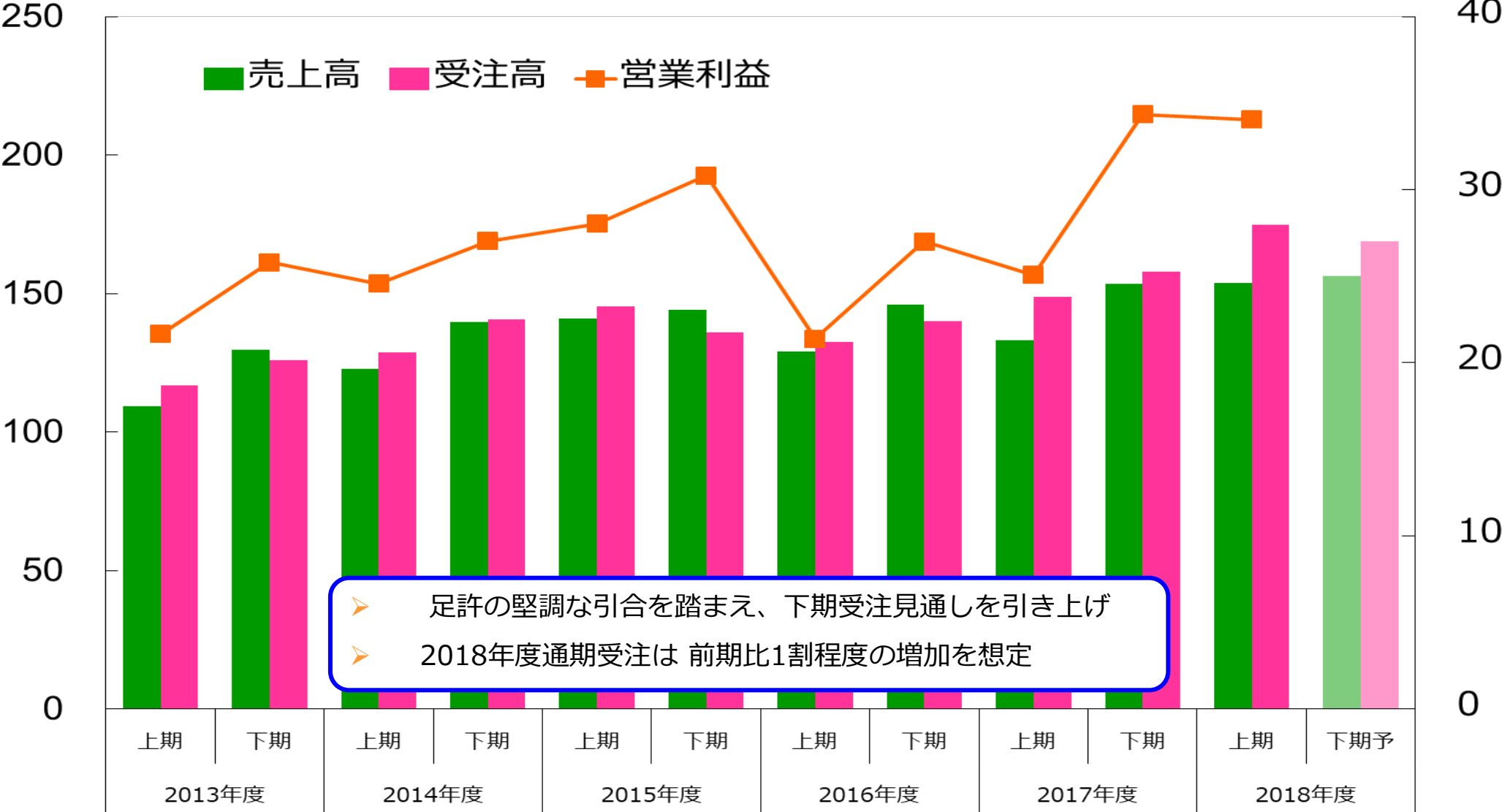


➤ 足許状況を踏まえ、下期受注見通しを引き下げ  
 ➤ 2018年度通期受注は 前期比1割程度の減少を想定

売上高・受注高(億円)

営業利益(億円)

■ 売上高 ■ 受注高 ■ 営業利益



➤ 足許の堅調な引合を踏まえ、下期受注見通しを引き上げ  
 ➤ 2018年度通期受注は 前期比1割程度の増加を想定

## (株)富士通テレコムネットワークス福島の株式取得(2019年2月1日発表)

- 充放電試験装置の開発等を行う同社の株式取得手続きを完了
- 今後は当社グループとして、エネルギー需要における安全な検査システムを提供
- 当社主力の「寸法測定」に「電気測定」という新たなラインナップを加え、幅広い計測ニーズへ対応
- 当社の連結業績に与える影響は軽微



<http://www.accretech.jp/>